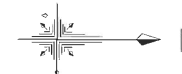


# シールド掘進・組立進捗図

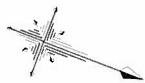


2021年12月1日現在  
493Ring掘進組立完了  
組立延長: 185.1m  
掘進延長: 190.7m



○: 路線計画図該当箇所

# シールド掘進・組立進捗図(詳細)



世田谷区  
玉堤二丁目

地盤変位測点 No.2

2021年12月1日現在  
495Ring掘進組立完了  
組立延長:185.7m  
掘進延長:191.3m

地盤変位測点 No.3

地盤変位測点 No.1



## 地盤変位量推移

2021年11月16日～2021年11月31日

